

L'Hybrid Memory Cube di Micron ottiene importanti encomi in relazione alla prossima generazione dei supercomputer

Il nuovo dispositivo di Micron supporta il petascale supercomputing, abbatte il muro di memoria e risolve le più grandi sfide dell'industria dei supercomputer

Boise, Idaho, 7 novembre 2013 (GLOBE NEWSWIRE) - Micron Technology, Inc., (Nasdaq: MU) ha oggi annunciato che sta pianificando di adattare il suo Hybrid Memory Cube (HMC) per i sistemi di petascale supercomputer, questo rappresenta un incredibile passo avanti nella tecnologia delle memorie. L'HMC è progettato per applicazioni che richiedono un basso consumo energetico e l'accesso ad un'alta larghezza di banda di memoria; quest'ultimo è il requisito più importante per i super computer. Altre applicazioni includono il data packet processing, il buffering o l'archiviazione del data packet e l'accelerazione del processore.

Durante la conferenza Supercomputing '13 Conference, che si terrà a Denver dal 19 al 21 novembre, sia Micron che Fujitsu, un leader mondiale nel supercomputing, presenteranno un tabellone che mostrerà i dispositivi HMC della prossima generazione dei prototipi di supercomputer di Fujitsu.

Supercomputing è una tecnologia essenziale che consente agli scienziati e agli ingegneri di affrontare simulazioni complesse che guidano la ricerca e lo sviluppo e consente loro di analizzare le domande fondamentali riguardanti l'organizzazione del nostro universo. Affrontare argomenti di questa portata richiede un'enorme capacità di trasferimento di dati. L'utilizzo di HMC per sbloccare il potenziale dell'architettura del processore multicore di un supercomputer, permetterà un'eccezionale efficienza nelle prestazioni.

"I progettisti e gli ingegneri di Fujitsu hanno previsto l'importanza nel portare il loro sistema ad un livello superiore con l'aiuto dell'Hybrid Memory Cube", ha dichiarato Brian Shirley, vicepresidente del gruppo DRAM Solutions di Micron. "Stiamo aiutando Fujitsu a far crescere immediatamente le loro capacità necessarie per affrontare le sfide informatiche più avanzate".

"I nostri progettisti di sistemi sono rimasti molto sorpresi di come HMC consenta di avere nuovi progetti di sistemi di memoria che supportino l'aumentata domanda della larghezza di banda, le dimensioni super compatte, e un consumo di energia ottimizzato per ogni bit", ha detto Yuji Oinaga, capo della Next Generation Technical Computing Unit di Fujitsu. "Per ottimizzare l'efficienza delle prestazioni del software applicativo è essenziale migliorare il rapporto B(byte)/F(flop), e HMC rappresenta il nuovo standard in termini di prestazioni della memoria per il supercomputing".

L'HMC, un passo avanti nell'industria, utilizza un'avanzata tecnologia through-silicon vias (TSVs), condotti verticali che collegano elettricamente una pila di singoli chip, per combinare la logica ad alte prestazioni con lo stato dell'arte della DRAM di Micron. L'HMC di Micron fornisce un'inedita larghezza di banda di memoria di 160 GB/s con un utilizzo fino al 70 per cento in meno di energia per bit rispetto alle tecnologie esistenti; tutto ciò abbassa drasticamente il costo totale di proprietà (TCO) per i clienti.

Aziende leader nel settore e opinionisti hanno riconosciuto l'HMC come la risposta tanto attesa al crescente divario tra il rapporto fra il miglioramento delle prestazioni della DRAM ed il livello di consumo del trattamento dei dati. L'HMC di Micron è stato recentemente nominato quale "Memory Product of the Year" da importanti pubblicazioni elettroniche come EDN e EE Times.

Micron prevede che la produzione in volumi di entrambi i dispositivi HMC da 2GB e 4GB inizierà nel 2014.

Micron Technology Inc. è uno dei maggior fornitori al mondo di soluzioni avanzate per semiconduttori. Attraverso i suoi impianti di produzione a livello mondiale la Micron produce e commercializza una gamma completa di memorie DRAM, memorie flash NAND e NOR, così come altre tecnologie di memoria innovative, moduli di memoria e sistemi a semiconduttori per l'uso in prodotti d'avanguardia, prodotti al consumo, per il networking, per la telefonia mobile e sistemi integrati. Le azioni ordinarie della Micron sono quotate al NASDAQ con il simbolo MU. Per ulteriori informazioni su Micron Technology Inc., visitare il sito www.micron.com

(C) 2013 Micron Technology Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Micron e il logo Micron sono marchi commerciali di proprietà di Micron Technology Inc. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti la disponibilità di campioni e la produzione in volumi dell'Hybrid Memory Cube. Eventi o risultati effettivi potrebbero discostarsi sostanzialmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali. Si prega di fare riferimento ai documenti depositati da Micron su base consolidata e in base alle scadenze periodiche, presso la Securities and Exchange Commission, in

particolare al modulo 10-K e al modulo 10-Q depositati più recentemente dalla Micron. Tali documenti contengono e identificano alcuni fattori importanti che potrebbero determinare che i risultati effettivi della Micron su base consolidata siano materialmente differenti da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali (vedi Determinati Fattori). Sebbene la società ritenga che le aspettative espresse nelle dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, essa non può garantire i risultati futuri, i livelli di attività, prestazioni o realizzazioni.

CONTATTO: Contatto Media di Micron:

Scott Stevens

+1-512-288-4050

sstevens@micron.com